

论坛四十八. 硅基芯片材料论坛

分会主席：赵超 石瑛

单元 48-1：10 月 9 日下午

主持人：赵超

地点：体育场二楼看台贵宾室 2

13:30-14:00 A48-01

高分辨率光刻胶及其产业化

杨国强

中国科学院大学

14:00-14:30 A48-02

相变存储器工艺和材料进展

宋志棠

中国科学院微系统研究所

信息功能材料国家重点实验室

14:30-15:00 A48-03

埋入式电容材料研究与产业化

孙蓉

中国科学院深圳先进技术研究院材料所

15:00-15:30 A48-04

硅基芯片制造技术进展和新材料

赵超

北京超弦存储器研究院

集成电路材料产业技术创新联盟

15:30-15:50 茶歇

15:50-16:20 A48-05

突破核心技术，打造核心竞争力，为全球产业链提供确切性

王学泽

宁波江丰电子材料股份有限公司

16:20-16:50 A48-06

从摩尔定律到三维集成的 CMP 工艺发展

王雨春

安集微电子科技（上海）股份有限公司

16:50-17:20 A48-07

半导体湿法工艺材料的需求及挑战

王溯

上海新阳半导体材料股份有限公司

单元 48-2：10 月 10 日上午

主持人：石瑛

地点：体育场二楼看台贵宾室 2

08:30-09:00 A48-08

掺氮直拉单晶硅中的若干研究进展

赵统

浙江大学

09:00-09:30 A48-09

基于二维材料的新型低功耗器件

杨雅芬

复旦大学

09:30-10:00 A48-10

用于制备集成电路抛光液的磨料面临的挑战与机遇

张保国

河北工业大学微电子与材料研究所

10:00-10:20 茶歇

10:20-10:50 A48-11

应用于 DRAM 高介电常数材料的进阶发展

李建恒

合肥安德科铭半导体科技有限公司

10:50-11:20 A48-12

IC 光刻胶技术探索及欣奕华进展

岳爽

阜阳欣奕华材料科技有限公司